



賀順企業股份有限公司
HISEN ENTERPRISES CO., LTD.
 E-mail : bill@mail.hisen.com.tw
 WEB SITE : http://www.hisen.com.tw
 地址：桃園縣龜山鄉萬壽路一段 540 號
 電話：886-2-8209-0214
 傳真：886-2-8200-0692

半導體產業預熱機型

特點

1. 品質優良，原料在短時間內加以預熱即能將濕氣及原料內之揮發成份消除，減小成品之變形、起泡、裂痕等不良品之產生。
2. 原料在短時間內即能達預熱效果，縮短原料在油壓機壓縮過程中的硬化時間，提高生產量。
3. 原料平均預熱，可增加成型品質的機械強度及尺寸精度。
4. 預熱溫度高，可減少所使用之壓力，延長模具之壽命。



技術規格

機型	HDP-323	HDP-323R	HDP-523	HDP-523R	HDP-723	HDP-723R
功率(KW)	3	3	5	5	7	7
頻率(MHZ)	72	72	72	72	72	72
最大入力(KVA)	7	7	11	11	14	14
外部尺寸(w*d*h-公分)	518*800*128 2	518*800*1282	518*945*128 5	518*945*1285	618*945*128 5	618*945*1285
紅外線測溫	無	有	無	有	無	有
重量(公斤)	180	180	260	260	300	300
電極方式	兩支滾筒三支滾筒電極					
用途	半導體封裝用					